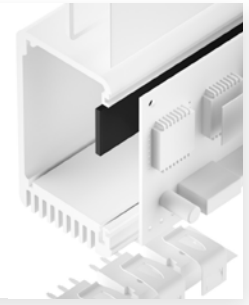


SILIKON GAP-FILLER PAD TEL-ZS-SI

weich, hoch thermisch leitfähiges Elastomer / minimierte volatile Siloxane (LV)



TEL-ZS-SI ist eine elektrisch nicht isolierende und extrem wärmeleitende LV Silikonfolie zur thermischen Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kühlflächen auch über größere Spaltmaße oder größere Toleranzen. Durch die Formulierung und spezielle Füllung des Materials ergibt sich eine extrem hohe anisotrope thermische Leitfähigkeit. Durch seine hohe Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt bei geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert.



Stand 02 / 2021

EIGENSCHAFTEN

- Weich und formanpassungsfähig
- Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)
- Elektrisch nicht isolierend
- Wärmeleitfähigkeit: 20 W/mK (anisotrop)
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend

LIEFERFORMEN

- Matte 120 x 120 mm (TEL-ZSXXXX-SI)
- Als lose Einzelteile
- Optional mit Klebestreifen oder -punkten (TEL-ZSXXXX-SI-A1)

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

- MOSFETs und IGBTs
- Dioden und Gleichrichter
- Elektronische Module z.B. in Wechselrichtern und Stromversorgungen / USV Einrichtungen / Motorsteuerungen / Automotiv-eanwendungen / Solartechnik

Technisches Datenblatt

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktkennung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befrein nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TEL-ZS0200-SI	TEL-ZS0500-SI
MATERIAL			
Farbe		Schwarz	Schwarz
Dicke	mm	0,2 ±0,05	0,5 ±0,05
Härte	Shore 00	60	60
Entflammbarkeit (Äquivalent)	UL 94	V0	V0
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja	Ja
THERMISCH			
Widerstand ¹ @ 250 kPa @ Dicke	°C-inch ² /W (mm)	0,007 (0,17)	0,018 (0,44)
Widerstand ¹ @ 100 kPa @ Dicke	°C-inch ² /W (mm)	0,017 (0,18)	0,027 (0,48)
Widerstand ¹ @ 50 kPa @ Dicke	°C-inch ² /W (mm)	0,030 (0,19)	0,042 (0,49)
Thermische Leitfähigkeit ¹	W/mK	20	20
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150
ELEKTRISCH			
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	< 50.000	< 50.000

Testmethode: ¹ ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.
 Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,2 mm / 0,3 mm / 0,5 mm

mm vs. N/cm² (PSI) / Rth vs. N/cm² (PSI)

